



信达证券
CINDA SECURITIES

Research and
Development Center

鸿蒙引领 IoT 芯机遇

电子行业周报

2021 年 6 月 6 日

证券研究报告

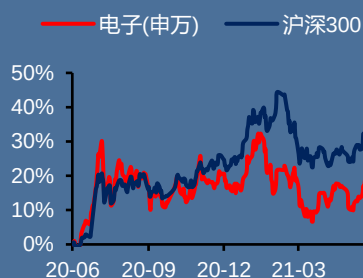
行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方 竞 电子行业首席分析师

执业编号：S1500520030001

邮 箱：fangjing@cindasc.com

李 少 青 电子行业分析师

执业编号：S1500520080004

邮 箱：lishaoqing@cindasc.com

刘 志 来 研究助理

邮 箱：liuzhilai@cindasc.com

童 秋 涛 研究助理

邮 箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

鸿蒙引领 IoT 芯机遇

2021 年 6 月 6 日

本期内容提要：

6 月 2 日，华为正式发布鸿蒙（Harmony）OS 2.0 以及多款搭载鸿蒙 OS 2.0 的 IoT 产品。鸿蒙 OS 作为新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化和互联互通提供了统一语言。

➤ 手机业务受限之下，鸿蒙 OS 是华为生态绝境求生的拐点

2019 年 8 月华为首次发布鸿蒙 OS，旨在提供面向手机、平板、手表、车机系统的统一操作系统。2020 年以来，华为手机业务则在芯片代工禁令之下受到重创。据 BCI 数据，2021 年第 21 周（5.17-5.23），华为+荣耀手机国内销量份额降至 16.1%，同比下降 33.5 个百分点。我们预计，2021 年全年华为出货量 4000 万台，荣耀出货量 3500 万台。

华为曾表示，操作系统存活的生死线是 16% 市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生态难以维系。华为通过对多设备的支持和开源共享吸引了美的、苏泊尔、九阳、魅族、科大讯飞等诸多合作伙伴加入，生态建设加速推进。华为预计，2021 年底，搭载鸿蒙系统的设备将超过 3 亿台，其中华为设备超过 2 亿台，第三方合作设备 1 亿台。伴随生态阵营的扩大，鸿蒙 OS 成为华为生态绝境求生的拐点。

➤ 何为鸿蒙 OS？

鸿蒙 OS 鸿蒙系统是华为基于 Open Harmony 开源项目（现已捐赠给开放原子基金会）的分布式多终端操作系统。现阶段为了实现对 AOSP 生态（即安卓生态）APP 的兼容，采用了 Open Harmony + AOSP 的双框架架构，而非部分人曲解的“安卓套壳”。

在鸿蒙 OS 上，华为主要做了两部分工作：（1）定义了以 Ability 为核心的应用开发框架，使其可以屏蔽不同操作系统的差异，使开发的代码可以在不同操作系统中运行；（2）采用“分布式软总线”技术，屏蔽了不同设备之间的通讯方式的差异，提供了稳定统一的通讯协议。基于此，鸿蒙 OS 实现了一次开发即可完成多端部署，应用场景涵盖手机、可穿戴设备、家具、汽车多场景，从操作系统层面解决了多个设备的协同和业务续接，提升设备互联的效率和便捷性。

➤ 连通设备孤岛，IoT 大时代来临，芯片投资价值凸显

百家争鸣的 IOT 行业亟待操作系统和连接方式的互联互通。当前 IoT 行业遍地开花，不乏爆款，但每个设备是一座孤岛，其运行不同的操作系统，使用不同的无线方式，终端之间的数据传输存在门槛。

鸿蒙 OS 是操作系统统一上一次成功的尝试，同时连接方式亦在持续演进，走向统一。早在 2019 年，谷歌、苹果、亚马逊便联合 Zigbee 成立 CHIP（Connected Home over IP）联盟，2021 年 5 月发布全新连接协议“Matter”，统一 Wi-Fi、蓝牙、Thread 等多种连接协议。可以预见，IoT 的大一统时代已经加速靠近，未来必将迎来更强的爆发。

在当前时点下，我们认为芯片端是 IoT 大时代来临前夕值得布局的投资板块。现将核心标的近况梳理如下。

乐鑫科技：Wi-Fi MCU 全球市占率达 35%+，2021 年新增产能 60%，同时公司亦于前期积极备货，Q1 存货达 2.07 亿元，在缺货行情下将成为公司出货保障，3-4 月的产品提价亦将助力今年业绩爆发；**恒玄科技**：TWS 耳机芯片龙头地位稳固，2021 年切入大客户三星，Q1 出货量 1500 万+。智能音箱和智能手表新业务迎来放量增长，预计营收贡献近 20%。智能音箱芯片切入天猫精灵，智能手表芯片切入华为 Watch GT；**中颖电子**：作为国内家电领域 MCU 龙头供应商，在小家电和白电领域具备领先优势。目前公司小家电 MCU 市占率达到 30%左右，白电领域尤其是变频 MCU 取得龙头客户认可，市占率有望持续提升，此外公司包含 WiFi 和蓝牙功能的产品有望在今年 Q4 量产，助力公司完善智能家居产品布局；**全志科技**：下游需求旺盛，智能家居芯片迎来爆发，扫地机器人芯片大客户石头科技一季报表现亮眼，公司全年出货有望翻倍增长，智能音箱芯片绑定大客户小米、百度，全年出货量上看千万；**瑞芯微**：卡位应用处理器芯片广阔赛道，产品广泛覆盖商业显示、扫地机器人、汽车电子等应用场景，最新产品制程水平已达 8nm，可实现 8K 超高清视频处理，将于今年正式量产。扫地机器人芯片围绕大客户科沃斯，主打高性能 AI 应用，有望受益下游市场高景气度。

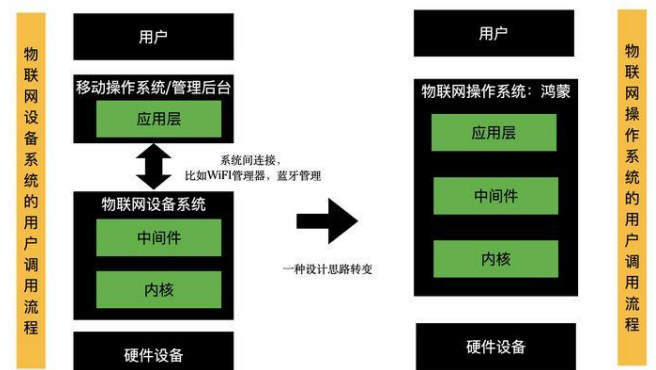
- **投资评级**：建议关注 IoT 芯片：乐鑫科技、恒玄科技、中颖电子、全志科技、瑞芯微；**半导体设计**：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、明微电子、富满电子、富瀚微；**功率半导体**：新洁能、士兰微、华润微、中车时代电气、斯达半导、闻泰科技。
- **风险因素**：市场竞争加剧；疫情持续，影响需求；技术渗透不及预期；中美贸易纠纷风险，半导体景气度下行风险。

图 1：Open Harmony 下不同终端的开发模式



资料来源：开放原子开源基金会，信达证券研发中心

图 2：HarmonyOS 与传统物联网系统的区别



资料来源：信达证券研发中心

目 录

附录一：上周市场回顾	5
附录二：上周科技新闻回顾	6
附录三：近期重要行业数据整理更新	11
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒	12

表 目 录

表 1：重要指数和价格变化	5
---------------------	---

图 目 录

图 1：Open Harmony 下不同终端的开发模式	3
图 2：HarmonyOS 与传统物联网系统的区别	3
图 3：电子行业子板块周涨跌幅（%）	5
图 4：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）	5
图 5：2021-2027 年各区域先进制程逻辑晶圆产能占比变化	11
图 6：全球主力 NB 品牌 2021 年出货预估（百万台）	11
图 7：2011-2021 全球 NB 出货变化	11
图 8：2020 年全球主要产业别半导体芯片采购金额（亿美元）	11
图 9：2020 年全球模拟 IC 供应商营收排名（亿美元）	11
图 10：2020 年全球模拟 IC 营收前十大厂商市占率	11

附录一：上周市场回顾

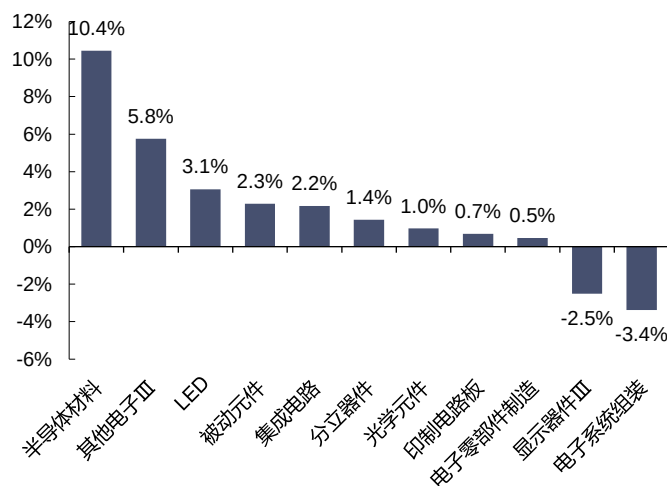
电子板块上周上涨 0.6%，跑赢沪深 300 指数 1.3 个百分点。年初至今电子板块下跌 0.6%，跑输沪深 300 指数 2 个百分点。上周电子行业子版块涨幅分别为半导体材料 10.44%，其他电子Ⅲ 5.76%，LED 3.06%，被动元件 2.29%，集成电路 2.17%，分立器件 1.44%，光学元件 0.97%，印制电路板 0.68%，电子零部件制造 0.47%，显示器件Ⅲ-2.51%，电子系统组装-3.38%。就个股而言，上周涨幅位于前列的分别是金运激光 34.0%，天华超净 28.2%，力合微 23.6%，世华科技 20.5%，精研科技 18.5%。

表 1：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	5282.3	-0.7%	1.4%	LME 铝	2455.0	-1.1%
上证综指	3591.8	-0.2%	13.6%	LME 铜	9960.0	-2.9%
中小板指	9567.9	0.6%	15.0%	DCE 塑料	7725.0	-0.4%
创业板指	3242.6	0.3%	7.2%	LME 镍	17985.0	-0.7%
道琼斯	34756.4	0.7%	9.4%	LME 锡	30800.0	0.2%
SOX	3214.1	0.9%	14.4%	LME 锌	3004.0	-1.8%
纳斯达克	13814.5	0.5%	17.4%	人民币汇率		
A 股电子	4707.4	0.6%	-0.6%	美元	6.407	0.34%
恒生科技	20697.9	3.7%	-1.5%	欧元	7.771	-0.14%
台湾加权	17147.4	1.6%	16.4%	100 日元	5.810	-0.02%
台湾 IT	23609.2	0.9%	14.0%	新台币对美元	27.552	-0.59%

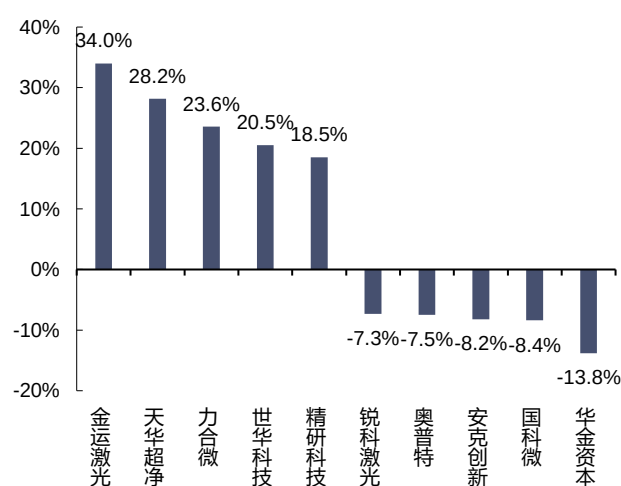
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 3：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 4：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

IDC 预计今年全球智能手机出货量将达 13.8 亿部

根据 IDC 的报告预测，2021 年全球智能手机出货量有望达到 13.8 亿部，同比增长 7.7%。这一趋势将持续到 2022 年，明年预计出货量达到 14.3 亿部，增长 3.8%。（手机技术资讯）

2H21 发布的苹果下一代 iPhone 中，超过 50%将支持 5G 毫米波技术

据 Digitimes，预计于 2H21 发布的苹果下一代 iPhone 中，超过 50%将支持 5G 毫米波技术。此外，新 iPhone 还将配备升级的调制解调器、功率放大器 (PA) 芯片以及石英组件。（闪信息）

苹果公布 2020 年供应链名单 新增 12 家陆企

苹果公司 5 月 28 日公布 2020 年 200 大供应链名单，与 2019 年的名单相比，大陆的新增企业数量最多，达到 12 家，整体新增家数超过所有国家与地区，凸显陆企在苹果供应链上的重要性日益增加。（中时新闻网）

目前已有 300 多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计 2021 年有 40 多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口

华为最新数据显示，目前已有 300 多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计 2021 年有 40 多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。华为表示，无论设备大小，只需一个系统就可以覆盖内存小到 128K，大到 4GB 以上等大大小小的智能终端设备。（闪信息）

旭日大数据统计：2020 年摄像头模组出货量 60 亿颗左右

旭日大数据统计：2020 年摄像头模组出货量 60 亿颗左右。旭日大数据分析师认为，2020 年销售手机所搭载的单机摄像头的平均数量增长 25.7%，所搭载的摄像头像素增速则更加迅猛；若仅考虑安卓手机，数量和像素增速更高，分别为 30.1%和 45.7%。（手机报）

小米宣布全球首发 200 瓦有线快充以及 120 瓦无线快充

小米宣布全球首发 200 瓦有线快充以及 120 瓦无线快充——200 瓦有线 8 分钟充满、120 瓦无线 15 分钟充满。小米 200 瓦有线快充演示机为魔改版小米 11 Pro，其电池容量为 4000 毫安。它通过 2 块电池串联的方式极大降低电池内阻，提升充电速度，降低充电温升。（闪信息）

中国智能手机制造商仍在增加对 OLED 面板的使用

据 UBI Research，尽管受到 COVID-19 大流行和美国的制裁，中国智能手机制造商仍在增加对 OLED 面板的使用。在 1Q21，中国共推出了 57 款使用 OLED 的智能手机。1Q21 智能手机 OLED 销售额达到 9.9 亿美元，同比增长 38.3%。增长得益于更多中国面板制造商制造高分辨率 OLED 面板，从而提高了单价。（闪信息）

2、半导体

集邦咨询：Q1 前十大晶圆代工厂商产值再创单季新高

TrendForce 集邦咨询研究显示,受惠于多项终端应用需求齐扬,各项零部件备货强劲,晶圆代工产能自 2020 年起便供不应求,各厂纷纷调涨晶圆售价及调整产品组合以确保获利水平。尽管整体产业历经 2020 年第四季的高基期、突发性停电意外等外部因素影响,2021 年第一季前十大晶圆代工业者总产值仍再次突破单季历史新高,达 227.5 亿美元,季增 1%。(集邦咨询)

兆易创新首款自有品牌 DRAM 产品正式发布

近年来,随着生活娱乐、车载影音、网络通信、智慧家庭等各种消费类电子应用的蓬勃发展,DDR4 接口的 DRAM 需求迅猛上升,未来更多新兴应用和产品的诞生,将进一步驱动市场对 DDR4 的需求。

6 月 3 日,兆易创新正式宣布,其首款自有品牌 4Gb DDR4 产品——GDQ2BF4A 系列现已量产,实现了从设计、流片,到封测、验证的全国产化,可用于机顶盒、电视、监控、网络通信、平板电脑、智慧家庭、车载影音系统等诸多领域。(全球半导体观察)

华虹半导体 12 英寸 90 纳米 BCD 实现规模量产

华虹半导体有限公司宣布,其 90 纳米 BCD 工艺凭借高性能指标及较小的芯片面积等优质特色,受到众多客户青睐,在华虹无锡 12 英寸生产线已实现规模量产。华虹半导体的 90 纳米 BCD 工艺拥有更佳的电性参数,并且得益于 12 英寸制程的稳定性,良率优异,为数字电源、数字音频功放等芯片应用提供了更具竞争力的制造方案。(华虹宏力)

长电科技完成收购 ADI 新加坡测试工厂

6 月 1 日,中国上海——全球领先的集成电路成品制造和技术服务提供商长电科技今日宣布,已正式完成对 Analog Devices Inc.新加坡测试厂房的收购,该厂房的测试人员将于近期陆续转入长电科技的生产环境中。(大半导体产业网)

台积电赴日投资将花费约 370 亿日元(3.37 亿美元),总费用的一半将由日本政府承担

台积电赴日投资将花费约 370 亿日元(3.37 亿美元),总费用的一半将由日本政府承担。与此同时,Ibiden 等 20 家日本厂商也将参与该计划,旨在开发最尖端的半导体制造技术。台积电的测试产线将于 2021 年夏天之后开始整备,预计 2022 年可正式开始研发。(闪信息)

联电 5 月营收近 172 亿 新高

晶圆代工厂联电 5 月合并营收出炉,年成长 16.6%至 171.89 亿元,改写单月历史新高。法人指出,联电在涨价效益及产能满载带动下,第二季合并营收可望季增个位数并改写单季新高,第三季营运也看好会更上一层楼。(中时电子报)

南亚科、威刚 5 月营收超旺

受惠于 DRAM 价格大涨,DRAM 厂南亚科及模组厂威刚 5 月营收同报佳绩。南亚科 5 月营收达 76.04 亿元,创下 32 个月新高,威刚 5 月营收达 36.33 亿元,亦创下历年同期新高。由于 DRAM 供不应求延续到年底,法人看好南亚科及威刚第二季营收表现将优于预期。(中时电子报)



超微携手台积电与 2H21 将加快小芯片架构处理器的先进制程研发及量产

超微(AMD)与晶圆代工厂台积电携手,2H21 将加快小芯片(chiplets)架构处理器的先进制程研发及量产。据了解,AMD 已向台积电预订 2022、后 2 年 5 纳米及 3 纳米产能,预计 2022 年推出 5 纳米 Zen4 架构处理器,2023-2024 年间将推出 3 纳米 Zen5 架构处理器,届时将成为台积电 5 纳米及 3 纳米高效能运算(HPC)最大客户。(闪存信息)

AI、5G 两大趋势强力推升需求 美光 看好记忆体旺到明年

记忆体大厂美光(Micron)执行长 Sanjay Mehrotra 参加今年台北国际电脑展(COMPUTEX)线上展,并以资料经济的创新(Innovation for the Data Economy)为题发表主题演说。Sanjay Mehrotra 指出,受惠于人工智慧(AI)及 5G 网路等二大趋势推升海量资料时代到来,加上资料中心、智慧边缘、消费终端等三大应用的运算及储存需求大跃进,预期记忆体市场将旺到明年。(中时电子报)

魏哲家: 3 奈米明年量产

台积电 2 日举办 2021 年技术论坛,总裁魏哲家表示,新冠肺炎疫情加速数位转型,高效能运算(HPC)应用已成为驱动半导体主要动能之一,台积电 2D 制程或 3DIC 技术将延续摩尔定律。台积电加速先进制程推进,去年研发费用达 37.02 亿美元创历史新高,2 奈米在奈米层片(nanosheet)装置取得重大突破。(中时电子报)

台积电扩产 盖 12 座晶圆厂

面对全球半导体产能供不应求,台积电在 2 日举办 2021 年技术论坛表示,3 年 1,000 亿美元投资案已全面启动,现在正以 5 倍的速度加快扩产脚步,包括将在南科扩建 5 奈米晶圆厂及兴建 3 奈米晶圆厂,以及在竹科兴建研发晶圆厂及 2 奈米晶圆厂,以台积电兴建中及计画中的投资案来看,等于要再盖 12 座晶圆厂,极紫外光(EUV)产能将大爆发。(中时电子报)

NVIDIA 合作伙伴推出采用 NVIDIA BlueField DPU 的全新伺服器

全球多家顶尖伺服器制造商在 2021 年台北国际电脑展(COMPUTEX)中,发表搭载 NVIDIA BlueField-2 DPU(资料处理器)的全新系统。儘管搭载 NVIDIA GPU 且可以选择加购 BlueField-2 DPU 的系统已经上市,但许多应用程式与客户的执行项目可能不需要 GPU,却仍然可受益于 DPU。(中时电子报)

3、汽车电子

成立新公司+打磨 6.0 芯片, 比亚迪半导体聚焦 IGBT 领域

5 月 27 日,西安比亚迪半导体有限公司(以下简称“西安比亚迪半导体”)在西安注册成立。西安比亚迪半导体由比亚迪半导体股份有限公司(以下简称“比亚迪半导体”)100%持股。据媒体此前报道,比亚迪半导体西安研发中心即将启用,与此同时,继 2018 年在宁波发布 IGBT4.0 芯片技术之后,比亚迪半导体打磨出了一款更高性能的 IGBT6.0 芯片,并计划于西安研发中心全新发布。(全球半导体观察)

恩智浦: 晶片短缺 持续与台积电紧密合作

IDM 大厂恩智浦半导体持续冲刺汽车、工业等市场,恩智浦半导体执行长 Kurt Sievers 表示,由于市场需求持续成长,不仅是恩智浦,整个产业首次面临晶片供应短缺、硅晶圆也呈现供应不足的局面,恩智浦将迈向更先进技术,以取得更多产能,未来会持续与台积电持续紧密合作。(中时电子报)

5月美国车市继续回暖 因芯片紧缺福特跌出前三甲

作为唯一一家公布单月销量的美国本土车企，福特汽车的5月销量却仅同比增长3.7%至16.1万辆，导致其在7家车企中的排名下滑至第4名，这是今年以来其首次跌出销量榜前三。福特出现如此严重的下滑，是受芯片紧缺的影响。5月集团旗下最畅销也是利润最高的车型——F系列被迫停产数周，使得该车型的销量同比下跌29%至4.6万辆，直接导致福特品牌乃至整个集团都增长乏力。（盖世汽车）

比亚迪半导体成立新公司，经营范围含集成电路芯片及产品制造

半导体是比亚迪的核心业务之一，业务涵盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。比亚迪半导体曾在2020年上半年完成过合计27亿元的两轮融资。经过两轮融资，比亚迪半导体投后估值达102亿元。企查查显示，5月27日，西安比亚迪半导体有限公司成立，法定代表人为陈刚，注册资本100万元人民币，经营范围包含集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片设计及服务、显示器件销售、集成电路芯片及产品销售等。（盖世汽车）

日产与Stellantis计划因芯片短缺暂停墨西哥工厂生产

日产在5月28日表示，受芯片短缺的影响，该公司将调整其生产计划。6月份该公司位于墨西哥的三座工厂将停工数天，具体停产日期不详。（盖世汽车）

4、面板/LED/PCB等

三星显示计划将采用超薄玻璃的可折叠有机发光二极管面板出售给其他智能手机厂商

三星显示(Samsung Display)计划将采用超薄玻璃(ultra thin glass, UTG)的可折叠有机发光二极管(OLED)面板出售给其他智能手机厂商，以加强其可折叠显示器业务。三星显示子公司Dolby Vision是全球首家实现UTG商业化的企业，薄加工的玻璃经过强化处理以增加柔韧性和耐用性，使其可以折叠和展开。（闪信息）

总投资2亿，泽华电子碳化硅封装项目厂房即将封顶

5月27日，辽阳泽华电子第三代半导体暨碳化硅封装生产线扩建项目厂房即将封顶。据公开信息显示，该项目总投资2亿元，位于辽宁辽阳市，总面积9973.01平方米。（LED inside）

总投资460亿元！广州华星新型显示器件项目完成招标

据广州日报27日报道，广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线施工总承包项目日前完成招标。据悉，该项目总投资为460亿元，建设工程费用为35.73亿元，为深圳市华星光电技术有限公司在黄埔区投建的印刷及可卷绕显示研发与生产基地。项目主要生产12.2英寸-55英寸4K/8K超高清高附加值IT产品（包括Monitor、Notebook、平板）、高端车载、医疗工控、航天航空等专业显示面板及Micro LED新型显示产品。（LED inside）

总投资6.3亿元，瀚天天成碳化硅项目主体封顶

日前，据厦门国家火炬高新区发布的消息显示，瀚天天成碳化硅产业园二期项目主体封顶。项目总投资6.3亿元，

位于同翔高新城占地面积 29002.015 平方米，其中一期项目已建成投产，建筑面积 18502.64 平方米，二期规划建筑面积 24133.03 平方米。项目拟建设 6 英寸 SiC 外延晶片生产线项目，建成投产后预计年产值 30 亿元。瀚天天成是华为哈勃投资的第一家碳化硅外延企业，此前华为哈勃已投资过山东天岳和北京天科合达两家碳化硅衬底企业。(LED inside)

京东方新一代玻璃基主动式 MiniLED 全面实现量产

京东方微信公众号 5 月 31 日消息，在 2021 国际显示技术大会 (ICDT 2021) 期间，京东方正式宣布全新玻璃基主动式 MiniLED 产品实现量产。据悉，京东方玻璃基 MiniLED 产品拥有 PCB 基所不具备的高精度、有源驱动、无屏闪、不易受热变形、高平整度、基板大型化等特点。(LED inside)

京东方第六代柔性 AMOLED 生产线预计年底在重庆投产

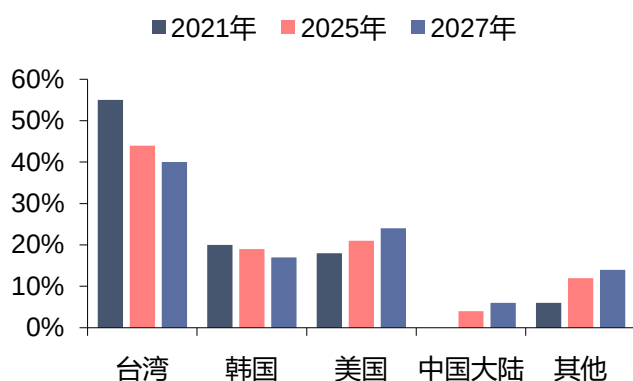
6 月 2 日，京东方在投资者互动平台上透露，重庆第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目将于今年年底投产，具体爬坡进度将根据客户及市场情况安排。据悉，该项目总投资 465 亿元，设计总产能为每月 4.8 万片玻璃基板，尺寸为 1500mm×1850mm，产品主要应用于手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品。(LED inside)

LG Innotek 出售 1 万项 LED 专利给中国企业

据报道，今年 5 月 20 日，LG InnoTek 将 1968 件 LED 相关专利出售给了中国苏州一家企业。虽然这家企业注册资本有 8000 万元，但并未生产任何 LED 相关产品。外界猜测，该公司可能是看重专利价值，做未来布局或者等升值后再度转售。加上此前收购的其它地区注册专利，该中企持有的原 LG LED 专利多达 1 万件。(LED inside)

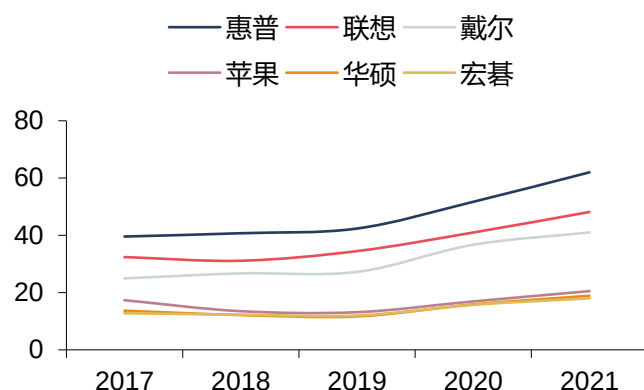
附录三：近期重要行业数据整理更新

图 5：2021-2027 年各区域先进制程逻辑晶圆产能占比变化



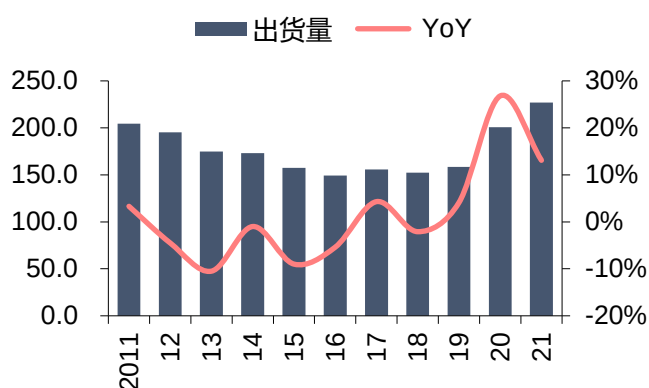
资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 6：全球主力 NB 品牌 2021 年出货预估 (百万台)



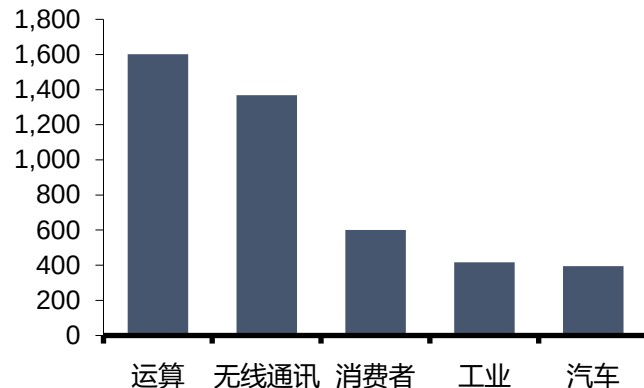
资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 7：2011-2021 全球 NB 出货变化



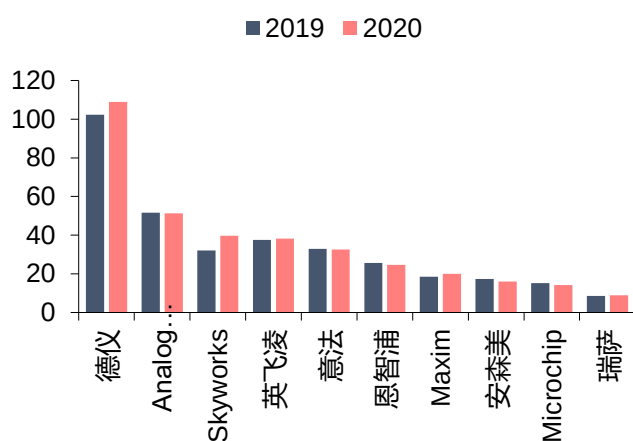
资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 8：2020 年全球主要产业别半导体芯片采购金额 (亿美元)



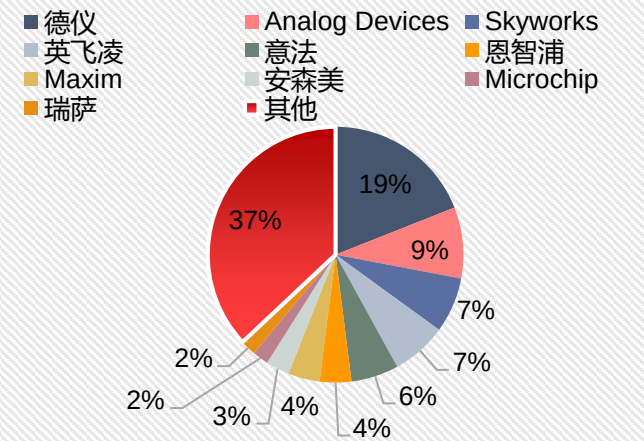
资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 9：2020 年全球模拟 IC 供应商营收排名 (亿美元)



资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 10：2020 年全球模拟 IC 营收前十大厂商市占率



资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【华峰测控】公司创始人、实际控制人之一、董事长孙铤先生于 2021 年 6 月 5 日因病去世，享年 72 岁。

【至纯科技】公司投资 5000 万元，参与成立合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙），合肥溯慈的认缴出资额专项用于认购合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）

【士兰微】公司拟与厦门半导体投资集团按目前股权比例，以货币方式同比例认缴士兰集科本次新增的全部注册资本 5 亿元，其中：本公司认缴 7500 万元；厦门半导体投资集团认缴 4.25 亿元。本次出资无溢价。增资完成后，士兰集科的注册资本将由 25 亿元增加为 30 亿元。

【圣邦股份】公司收到世纪维盛的《关于股东股份减持计划提前结束的告知函》，世纪维盛本次减持计划已实施完毕。截至本公告日，世纪维盛于 2021 年 5 月 24 日，通过大宗交易方式合计减持 240.19 万股，占公司当时总股本的 1.54%。

【捷微电】公司发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 11.95 亿元，扣除发行费用后用于功率半导体“车规级”封测产业化项目。

【乐鑫科技】公司股东 Shinvest 本次拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 320.45 万股，不超过公司目前总股本的 4%。亚东北辰本次拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 480.68 万股，不超过公司目前总股本的 6%。

【歌尔股份】经公司总裁姜龙先生提名，董事会同意聘任李友波先生、朱胜波先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

【精测电子】持武汉精测电子集团股份有限公司股份 105.74 万股（占公司总股本比例 0.38%）的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）计划减持期间内拟减持不超过公司总股本 0.38% 的股份，即 105.74 万股

研究团队简介

方 竞，西安电子科技大学本硕连读，近 5 年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台 IC 咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017 年在太平洋证券，2018 年在招商证券，2020 年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获 19 年新财富电子行业第 3 名；18/19 年《水晶球》电子行业第 2/3 名；18/19 年《金牛奖》电子行业第 3/2 名。

李少青，武汉大学硕士，2018 年加入西南证券，2020 年加入信达证券，覆盖半导体产业链。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020 年加入信达证券，覆盖消费电子产业链。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020 年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北副总监 (主持工作)	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北	欧亚菲	18618428080	ouyafei@cindasc.com
华北	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华东副总监 (主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东	孙斯雅	18516562656	sunsiya@cindasc.com
华东	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华南总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com
华南	江开雯	18927445300	jiangkaiwen@cindasc.com
华南	曹曼茜	18693761361	caomanqian@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。